КАРИМОВ А.В., ЁДГОРОВА Д.М.

ИНЖЕКЦИОННО-ПОЛЕВОЙ ФОТОДИОД

Предложен фотодиод на основе pAlInGaAs—m-переходов. Высокая фоточувствительность в нем достигается в режиме прямого смещения p—n-гетероперехода и запирания n—m перехода. В этом режиме освещение структуры из собственной или примесной области спектра приводит к уменьшению сопротивления базовой области за счет генерированных фотоносителей, что приводит к последующему увеличению инжекционного тока через прямо смещаемый p—n-переход. При этом с увеличением приложенного напряжения поле на запираемом n—m-переходе возрастает. Такие фотодиоды могут использоваться для регистрации оптического и лазерного излучений в диапазоне 0.8...1,6 мкм.

В настоящее время в оптико-электронных системах для приема лазерного излучения используются полупроводниковые фотодиоды на основе Si и полупроводниковых соединений A^3B^5 . Разработано несколько типов пороговых быстродействующих фотодиодов, в том числе со структурой p^+pn^+ , лавинные фотодиоды со структурой n^+ppn и другие [1]. Необходимый режим работы в них обеспечивается в условиях, близких к пробою, когда обратные токи сильно возрастают, в результате наблюдается смещение рабочей точки и нестабильности параметров. Коэффициент умножения сильно зависит как от интенсивности света, так и от напряжения, которое необходимо поддерживать с точностью 0.02% [2]. В случае структур с разделением областей поглощения и умножения имеют место большие туннельные токи при перекрытии области поглощения объемным зарядом обратно смещенного перехода [3].

Указанных недостатков лишены трехбарьерные фотодиодные структуры Au—nAlGaAs-pGaAs—Ag с внутренним усилением [4—6], которые также работоспособны при оптическом возбуждении с любой из сторон и при любой полярности рабочего напряжения [7]. К классу структур с внутренним усилением можно отнести предлагаемый в данной работе инжекционно-полевой фотодиод.

Фотодиод состоит из полупроводника с p-n-переходом с длинной базовой областью nGaAs. Область p-типа получена выращиванием из жидкой фазы эпитаксиального слоя pAlInGaAs(Zn) в виде микрослоев на подложках nGaAs, легированных кислородом. Толщина верхнего эпитаксиального слоя pAlInGaAs составляет \sim 1 мкм, а области nGaAs — 350 мкм. Концентрация носителей в эпитаксиальном слое pAlInGaAs(Zn) составляет $4\cdot10^{17}$ см $^{-3}$, а в подложке $4\cdot10^{15}$ см $^{-3}$. Со стороны пленки pAlInGaAs напылением в вакууме через маску нанесены омические контакты из Au+Zn, а с тыльной стороны подложки сформирован полупрозрачный (60...70 Å) выпрямляющий контакт из Ag. Таким образом, структура имеет два выпрямляющих перехода, один гетеро